

開催概要

会議名称：第14回紫外線・電子線硬化技術国際会議
RadTech Asia 2016
(The 14th International Conference on Radiation Curing in Asia)

会 期：2016年10月24日(月)～10月27日(木)

会 場：ヒルトン東京お台場(ホテル日航東京)

主 催：RadTech Asia 2016 組織委員会

共 催：RadTech Asia Organization

後 援：一般社団法人ラドテック研究会

アドバイザーボード

Xavier Allonas
University of Haute Alsace, France

Gary Cohen
Radtech International North America, USA

Kurt Paul Dietliker
Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland

Paul Elias
Miwon Specialty Chemical Co., Ltd., Korea

David Harbourne
Heraeus Noblelight N.America, USA

David Helsby
RadTech Europe, Switzerland

In Hyo Kim
RadTech Korea and Shinyoung Radchem, Korea

Tokuji Miyashita
Tohoku University, Japan

Jun Nie
Beijing University of Chemical Technology, China

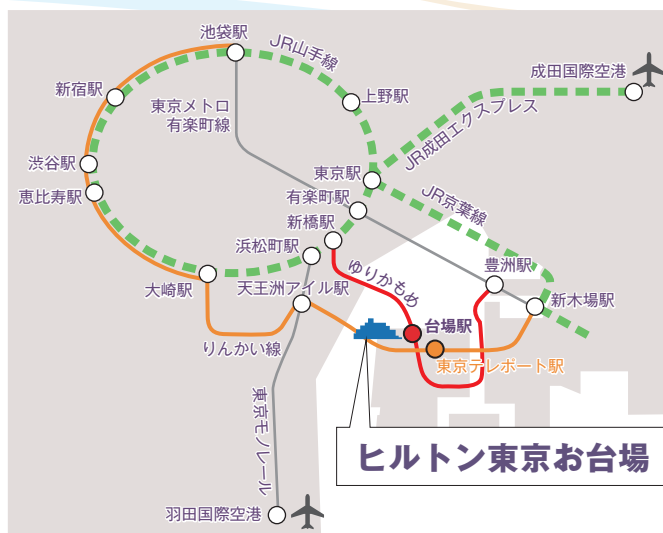
Wenfang Shi
University of Science and Technology of China, China

Masakazu Washio
Waseda University, Japan

Andrew Whittaker
The University of Queensland, Australia

Jianwen Yang
RadTech China & Sun Yat-sen University, China

会場案内・アクセス



会場：
ヒルトン東京お台場(ホテル日航東京)
〒135-8625 東京都港区台場1-9-1
電話：03-5500-5500 / Fax：03-5500-5525

電車でのアクセス：ゆりかもめ「台場」駅直結

路線	駅	所要時間のめやす
ゆりかもめ	新橋駅～台場駅	15分
	豊洲駅～台場駅	16分

※東京テレポート駅からは徒歩 約10分
無料シャトルバスをご利用いただけます
<http://www.hnt.co.jp/access>

お問合せ先

RadTech Asia 2016 事務局
〒101-8449 東京都千代田区猿樂町1-5-18 千代田ビル
c/o 株式会社 ICS コンベンションデザイン内
TEL: 03-3219-3541 FAX: 03-3219-3577
E-mail: radtech16@ics-inc.co.jp

第14回 紫外線・電子線硬化技術国際会議

RadTech Asia 2016

Innovation Challenges with
New UV/EB Technologies



October
24-27, 2016
Tokyo,
Japan

Sponsored by
RadTech Japan

<http://radtech-asia.org/radtechasia2016.html>

国際会議ラドテック・アジア2016は、"Innovation Challenges with New UV/EB Technologies" (新規UV/EB技術によるイノベーションへの挑戦)を主題として、RadTech Asia 2016 組織委員会が主催し、2016年10月24日から27日の4日間、ホテル日航東京(本年10月1日より、ヒルトン東京お台場に改称)にて開催いたします。

ラドテック研究会は国際的な協力を基にUV/EB技術の開発とその進展を真摯に探究しています。

ラドテックと呼称する協会は、北米大陸をはじめとして、中国、ヨーロッパ、日本など、グローバルな各地域において、独自に組織化を行い、協会を運営し、各々連携して技術的な会議やイベントを開催しています。ラドテック・アジアは、全アジア地域のUV/EBに関連するイベントであり、中国、韓国、マレーシア、そして日本のラドテック組織が参画し、当ラドテック研究会が2011年以降の主催団体となります。製造技術および、そのプロセスは日本から端を発したものが数多く、それに続いてアジア近隣諸国に取り入れられ発展し、特にIT分野においては顕著となっております。今日の経済を成長、継続させ、グローバルマーケットにおける厳しい競争に打ち勝つためには、日本はイノベーションを持続させたものにならなければならないと考えます。

UV/EB技術は様々な産業界に潜在するイノベーションを可能とするポテンシャルが存在し、特にグラフィックス分野においてはディスプレイ、タッチパネル、記録媒体、自動車部品、そして電子部品などの製造プロセスにおいてUV技術の利用・発展が顕著となっていることが、その証であります。アカデミア、そして産業界による研究開発と研究所は、過去には不可能とされた性能を有するポリマーネットワークなどの新規材料の開発を継続して行っております。

ラドテック・アジア2016はUV/EB技術についての詳細な理解を認識する場であり、最新のイノベーションの可能性を見出せる講演やノートが、アジアのみならず世界各地から集まります。イノベーションの波はラドテック・アジアを通じて、あちこちで起こる小集団による活発な討議が不可欠と考えます。また、今日の産業界は、製品製造に関し、明日に向けた、更に高い環境親和性、生産性、製品性能を探し求め、新規なUV/EB技術の可能性について注目しています。ラドテック・アジアの国際会議から新たなイノベーションが見出せるよう、皆様方のご参加をいただけるよう、切にお願いいたします。

折笠輝雄

RadTech Asia 2016組織委員長
一般社団法人ラドテック研究会 会長
折笠輝雄



基調講演

天野 浩 教授

名古屋大学工学研究科
電子情報システム専攻電子工学分野
(2014年ノーベル物理学賞受賞)

日時：10月25日(火) 午後(予定)



セッション概要(予定)

Special Sessions:

- S-1 LED related technology
- S-2 3D printing technology
- S-3 Printed electronics
- S-4 Lithography and Nanoimprint

General Sessions:

- G-1 Radiation and Photochemistry
- G-2 Advanced materials and Applications
- G-3 Radcure equipment, Testing, and Measurement
- G-4 Functional coatings
- G-5 Others (Formulations, Sustainable application, etc)

アブストラクト投稿 投稿締切：2016年春

RadTech Asia 2016にて研究成果の発表をご希望の場合はウェブサイトに掲載の要項に従ってご投稿くださいますようお願いいたします。オンライン投稿システムからのご投稿のみ受理いたします。ファックスやメールでのご提出はお受けできませんのでご了承ください。採用された論文は、口頭ポスターでの発表となります。

早期参加登録締切：2016年夏

展示会 出展募集要項

▶概要

RadTech Asia 2016展示会

2016年10月24日(月)～27日(木)

主催：RadTech Asia 2016 組織委員会

後援：一般社団法人ラドテック研究会

▶出展料とブースの基本仕様

—Aタイプ— (募集小間数：43小間)

会場：オリオンの間(ヒルトン東京お台場 1F)

1小間： 250,000円(税込)

2小間以上： 200,000円(税込) / 1小間につき

1小間のサイズ：間口1.98メートル×奥行1.98メートル、高さ2.4メートル

—Bタイプ— (募集小間数：5小間)

会場：1Fホワイエ(オリオンの間 外)

1小間： 100,000円(税込)

※複数小間の申込はできません。

1小間のサイズ：間口1.98メートル×奥行0.45メートル、高さ2.4メートル

▶出展社特典

出展社には以下の特典を付与いたします。

1. Buffet Dinner (25日夜開催) に、出展社1社につき1名様をご招待(Aタイプのみ)
2. Proceedings (論文集) を1社につき1部

▶お申込方法

2015年9月1日以降に申込書に必要事項を記載し、FAXまたはE-mailにて事務局にご送付ください。

※申込書は2015年7月頃よりウェブサイトにて入手してください

展示申込締切：2016年6月30日(木)

Aタイプの位置はお申込順にてご希望を承ります。

申込書には第2希望もご記入ください。

受付手続き完了後、E-mailにて確認書をお送りいたします。

詳細に関しては、ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.radtech-asia.org/radtechasia2016.html>

※出展募集要項の詳細は2015年7月頃に掲載いたします